

# JIS

## プリント基板の設計，製造及び組立ー用語ー 第1部：プリント基板及び電子実装技術共通

JIS C 60194-1 : 2023

(JSA)

令和5年11月20日 制定

認定産業標準作成機関 作成・審議

(日本規格協会 発行)

一般財団法人日本規格協会 電子分野産業標準作成委員会 構成表

	氏名	所属
(委員長)	平 本 俊 郎	東京大学
(委員)	石 井 紀 彦	日本放送協会
	河 村 真紀子	主婦連合会
	西 城 武 志	総務省国際戦略局
	渋谷 隆	株式会社白山
	諏訪 正 樹	KOA 株式会社
	内 藤 恵美子	公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会
	藤 井 哲 郎	東京都市大学名誉教授
	松 井 隆	日本電信電話株式会社
	山 田 誠	大阪公立大学

---

主 務 大 臣：経済産業大臣 制定：令和 5.11.20

担 当 部 署：経済産業省産業技術環境局 国際電気標準課

(〒100-8901 東京都千代田区霞が関 1-3-1)

官 報 掲 載 日：令和 5.11.20

認定産業標準作成機関：一般財団法人日本規格協会

(〒100-0073 東京都港区三田 3-13-12 三田 MT ビル)

素 案 作 成 者：一般社団法人電子情報技術産業協会

(〒100-0004 東京都千代田区大手町 1-1-3 大手センタービル)

審 議 委 員 会：電子分野産業標準作成委員会 (委員長 平本 俊郎)

この規格についての意見又は質問は、上記認定産業標準作成機関又は素案作成者にご連絡ください。

なお、日本産業規格は、産業標準化法の規定によって、少なくとも5年を経過する日までに見直しが行われ速やかに確認、改正又は廃止されます。

## 目 次

	ページ
序文	1
1 適用範囲	1
2 引用規格	1
3 用語及び定義	1
3.1 A	2
3.2 B	14
3.3 C	30
3.4 D	54
3.5 E	64
3.6 F	73
3.7 G	84
3.8 H	87
3.9 I	94
3.10 J	99
3.11 K	100
3.12 L	101
3.13 M	108
3.14 N	117
3.15 O	121
3.16 P	125
3.17 Q	142
3.18 R	143
3.19 S	153
3.20 T	176
3.21 U	187
3.22 V	189
3.23 W	193
3.24 X	198
3.25 Y	199
3.26 Z	199
附属書 JA (参考) 用語索引	200
参考文献	253
附属書 JB (参考) JIS と対応国際規格との対比表	254
解 説	260

## まえがき

この規格は、産業標準化法第 14 条第 1 項の規定に基づき、認定産業標準作成機関である一般財団法人日本規格協会（JSA）から、産業標準の案を添えて日本産業規格を制定すべきとの申出があり、経済産業大臣が制定した日本産業規格である。

この規格は、著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が、特許権、出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣は、このような特許権、出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認について、責任はもたない。

# プリント基板の設計，製造及び組立—用語—

## 第1部：プリント基板及び電子実装技術共通

### Printed boards design, manufacture and assembly—Vocabulary— Part 1: Common usage in printed board and electronic assembly technologies

#### 序文

この規格は、2021年に第1版として発行された **IEC 60194-1** を基とし、対応国際規格の明らかな誤記の修正を行い、技術的内容を変更して作成した日本産業規格である。

なお、この規格で、**附属書 JA** 及び参考文献は、対応国際規格にはない事項である。また、側線又は点線の下線を施してある箇所は、対応国際規格を変更している事項である。技術的差異の一覧表にその説明を付けて、**附属書 JB** に示す。

#### 1 適用範囲

この規格は、主にプリント基板及び電子実装技術に密接に関わる用語及び定義について規定する。

**注記** この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を、次に示す。

**IEC 60194-1:2021**, Printed boards design, manufacture and assembly—Vocabulary—Part 1: Common usage in printed board and electronic assembly technologies (MOD)

なお、対応の程度を表す記号“MOD”は、**ISO/IEC Guide 21-1** に基づき、“修正している”ことを示す。

#### 2 引用規格

次に掲げる引用規格は、この規格に引用されることによって、その一部又は全部がこの規格の要求事項を構成している。この引用規格は、その最新版（追補を含む。）を適用する。

**IEC 60050** (all parts), International Electrotechnical Vocabulary

#### 3 用語及び定義

用語及び定義は、次による。

**注記** この規格では、対応国際規格に従いアルファベット順に記載している。**附属書 JA** に日本語の索引を記載している。